

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
 【発行日】 平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公開番号】 特開 2006-66677 (P2006-66677A)
 【公開日】 平成 18 年 3 月 9 日 (2006.3.9)
 【年通号数】 公開・登録公報 2006-010
 【出願番号】 特願 2004-247922 (P2004-247922)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 G

H 0 1 L 21/02 Z

H 0 1 L 21/304 6 4 8 H

【手続補正書】
 【提出日】 平成 19 年 6 月 4 日 (2007.6.4)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 1 2
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 2】

図 1 は、本発明の第 1 実施形態の構成を示すブロック図である。

この第 1 実施形態に係る半導体製造システムは、半導体処理装置として、図 1 に示すように、被処理物に対して同一のドライエッチング処理を行うことができる、少なくとも 2 つの同一のドライエッチング装置 1、2 を備えている。

この各ドライエッチング装置 1、2 は、チャンバ 1 1、2 1 をそれぞれ備え、チャンバ 1 1、2 1 内において、被処理物に対してプラズマ発光などを用いてそれぞれ同一のドライエッチング処理ができるようになっている。また、チャンバ 1 1、2 1 内は、ドライエッチング処理後などに必要に応じてクリーニング（清掃）ができるようになっている。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 1 6
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 6】

メモリ 8 は、データ処理部 7 がデータ処理を行う際に必要なデータを予め格納するとともに、そのデータ処理の際に一時的にデータを格納するものである。

制御部 9 は、ドライエッチング装置 1、2 のチャンバ 1 1、2 1 において、ドライエッチング処理やクリーニング処理を行う際に、その処理に係る各部（図示せず）の制御を行うものである。ここで、その制御パラメータとしては、ガスの流量、高周波電源の電圧値、圧力、温度などがある。